

2006年年会 リエゾンセッション 報告

会員の皆様が年会で発表されるご研究には、「セラミックス材料の実用化に向けて官学界が育成しており、これに産業界が加わることによって実際の製品化が期待される研究」、「産業界が抱えている、新製品や現製品に係る技術的課題を解決することのできる研究」、「現行技術の応用展開や技術的な試験および評価に対応する研究」、「セラミックスのエンドユーザーにとって広く将来の研究開発やビジネスの種となる研究」など、産官学界相互の新たな連携を生み出すことが可能なものが多く含まれています。リエゾンセッションは、ご所属に関わらず会員の皆様に自由にご発表いただくことができる年会の特徴に「相互連携」の視点を加えたセッションであり、上記のような研究に関する各界からの活発なご発表の場、参加される皆様にはより深い交流の場となりますことを願い設置したものです。

初めての試みとなった2006年年会では、分野ごとにリエゾンセッションを組み、初日から最終日まで、それぞれの時間帯が重ならないようにプログラムを編成しました。年会直前には、日刊工業新聞紙上に「年會に研究交流の“場”ーリエゾンセッション新設」と題して紹介記事(2006年3月10日付)も掲載されました。また、年会予稿集の冒頭にリエゾンセッション一覧を掲載し、総合受付付近には案内用のポスターも掲示して、より多くの皆様にご聴講いただけるよう努めました。各分野のリエゾンセッション発表件数は次の通りです。

- 電子材料(誘電体) 4件
- 電子材料(誘電体以外) 6件
- 陶磁器 1件
- 環境・資源関連材料 2件
- セメント 1件
- ガラス・フォトニクス材料 3件
- 生体関連材料 4件
- エネルギー関連材料 6件
- 高温・構造材料 11件



おかげさまで、どのセッションも、立ち見が出るほど盛況で、企業からのご発表も注目を集めていました。ご発表・ご聴講いただいた皆様に心より御礼申し上げます。なお、後日談ですが、エネルギー関連材料セッションでのあるご発表に対し、年会後に、専門の機関誌に技術情報として執筆をお願いしたいとの依頼が寄せられるなど、反響もございました。

一般の各セッションはもちろんですが、リエゾンセッションでの産業界からのご発表もお待ちしております。先月号の本欄でもご紹介申し上げましたように、「産業間の連携」につながるようなご研究も、セラミックス技術の進展と業界全体の発展にとって重要なものと考えております。リエゾンセッションへのお申し込みは本号の2007年年会会告をご参照ください。審査は行わず、全てリエゾンセッションに組み込ませていただきます。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。